

企業名	日清紡マイクロデバイスAT株式会社
-----	-------------------

■代表者	代表取締役社長 末吉 裕明
■URL	http://www.nisshinbo-microdevices-at.co.jp
■所在地	〒 842-0032 神埼郡吉野ヶ里町立野950
■TEL	0952-52-3249
■FAX	0952-52-3214
■資本金	50000千円
■従業員	450名

■主要製品名	半導体集積回路(IC)
■得意とする加工内容	ICアッセンブリー・テスト
■主要取引先	日清紡マイクロデバイス株式会社
■その他	

■連絡担当者	事務部 人事課 内川 巖
■E-mail	

■企業の特徴

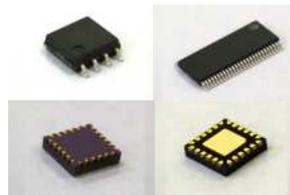
当社は1965年創業以来、日清紡マイクロデバイス株式会社のグループ企業として、半導体の製造を行っています。

社会が急速に変化するなか、企業としての理想や目標の実現に向かって「挑戦と変革」を続け、社会の一隅を照らす企業を目指します。

半導体生産においては、ウェハープロセス以降の後行程に対応し、小型・薄型のタイプ(リードタイプ、リードレスタイプ)を中心に、お客様の用途に応じた形状のパッケージを各種取り揃えて生産しています。

品質面では、お客様の満足を第一に品質改善、品質向上に取り組んでおり、ISO9001/IATF16949を認証取得し確かな品質の製品を提供しております。また、環境マネジメントシステムもISO14001を認証取得しており環境問題にも積極的に取り組んでいます。TS16949を2007年に認証取得し、その後IATF16949を取得し、車載製品の生産、納入を行っております。

また、近年は長年の半導体組立で培った技術と経験の蓄積により、より高付加価値領域へ、また半導体を作る企業から使う企業へ事業領域を拡大し、新たな市場へと挑んでいます。



ISO/IATF16949:2016
Certified
JQA-AU0170



ISO14001:2015 Certified
JQA-EM2049
SAGA WORKS



機械設備名	型式・能力	台数
ウェハ加工及びテスト設備	バックグラインダー	1 台
	トリミング装置	2 台
	ウェハソーター	1 台
	テスター	16 台
	ブローバー	23 台
IC組立及びテスト設備	テープ貼り装置	5 台
	ダイサー	10 台
	ダイボンダー	29 台
	ワイヤーボンダー(FCB含む)	53 台
	モールド装置	14 台
	切断装置	16 台
	マーキング装置	6 台
	テストハンドラー	57 台
	テスター	78 台
	テーピング装置	29 台
	ブローバー	10 台
	その他	15 台